光电半导体的应用主要为设备清洗，而热喷涂在该领域有两种工艺制程，分别为等离子喷涂与电弧式喷涂其应用也不太相同，以等离子喷涂来说，所喷涂的材料为氧化铝和氧化钇涂层，也就是业界所称的A Coating 和Y Coating，主要用来抵抗等离子的轰击造成腔体的损坏。另外一种电弧式喷涂的工艺则是喷涂纯铝线，使腔体内部表面具有高粗糙度，经过尖端放电的效果来捕捉腔体内部的带电粒子，防止这些粒子影响良率。

应用领域：面板厂电极板

使用材料：氧化铝

使用制程：等离子喷涂

涂层应用：抗等离子侵蚀

前往了解等离子设备

应用领域：半导体厂石英坩埚

使用材料：氧化铝

使用制程：等离子喷涂

涂层应用：抗等离子侵蚀

前往了解等离子设备

应用领域：面板厂内部设备元件

使用材料：纯铝线

使用制程：电弧式喷涂

涂层应用：抗等离子侵蚀

前往了解电弧式喷涂设备

近年来光电半导体厂对于抗等离子侵蚀的要求越来越严苛，依照现有的热喷涂技术水平使用寿命无法达到这些制造商的要求，而有部分的科研单位发现现有的涂层孔隙率不够低，在对抗等离子侵蚀时的效果有限，如果可以降低涂层的孔隙率也可以增加这些设备的使用寿命减少，更换零件所牺牲的生产时间，增加生产效率。而在减少涂层孔隙率的工艺中，使用大气浆料等离子喷涂(ASPS)是目前可以在不增加过多的设备成本的前提下有效降低涂层中的孔隙率，提升工件寿命的方法之一。在国外也有原料供应商与设备商开发出高致密性与高堆积效率的ASPS系统。

应用领域：面板/半导体厂内部设备元件

使用材料：氧化铝浆料

使用制程：大气浆料等离子喷涂(ASPS)

涂层应用：抗等离子侵蚀

前往了解大气浆料喷涂设备

前往了解热喷涂用浆料

应用领域：面板/半导体厂内部设备元件

使用材料：氧化钇浆料

使用制程：大气浆料等离子喷涂(ASPS)

涂层应用：抗等离子侵蚀

前往了解大气浆料喷涂设备

前往了解热喷涂用浆料